

2011-2015年中国数字电视 芯片行业市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国数字电视芯片行业市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/tongxun1112/5912853SAW.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7500元

【出版日期】2011-12-02

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国数字电视芯片行业市场分析与投资前景研究报告》共十章。首先介绍了中国数字电视芯片行业的概念，接着分析了中国数字电视芯片行业发展环境，然后对中国数字电视芯片行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国数字电视芯片行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国数字电视芯片行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

第一章 数字电视宏观环境

第一节 三网融合

第二节 视频传输通道

一、有线数字电视

二、卫星数字电视

三、地面数字电视

四、IPTV

第二章 2011年中国数字电视产业运行动态分析

第一节 2011年中国数字电视市场发展分析

一、中国数字电视大事记

二、中国数字电视市场发展现状

三、中国数字电视整机和关键件开发生产情况

四、拉动中国数字电视产业发展的热点

五、数字电视一体机发展分析

六、年京沪数字电视产业发展情况

七、中国地面数字电视信号开通情况及运营特点

第二节 2011年中国数字电视技术标准研究

一、国际主要数字电视标准

二、中国数字电视技术标准战情况

三、中国数字电视技术标准化工作的进展综述

四、等离子数字电视新标准助推产业发展

第三节 2011年中国数字电视存在的问题分析

一、数字电视商业模式问题及创新

二、中国数字电视的发展瓶颈

三、广州数字电视的弊端

第三章 2011年中国数字电视芯片行业市场发展环境分析

第一节 国内宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2011年中国宏观经济发展预测分析

第二节 中国数字电视芯片行业政策环境分析

第四章 2011年中国数字电视芯片行业运行形势分析

第一节 2011年中国数字电视芯片发展分析

一、国产数字电视芯片研制取得突破进展

二、USB数字电视芯片及应用

三、中国数字电视打破国外芯片市场垄断

四、中国电子数字电视内容保护芯片研制取得突破进展

五、数字电视终端与芯片的智能化探讨

第二节 2011年中国数字电视芯片技术分析

一、芯片技术发展趋势

二、芯片技术发展对机顶盒的影响

第三节 2011年中国数字电视芯片发展存在问题分析

第五章 2011年中国数字电视芯片市场运行形势分析

第一节 2011年中国数字电视芯片市场概述

一、有线市场

二、卫星市场

三、地面市场

四、高清市场

第二节 2011年中国数字电视芯片市场动态分析

一、数字电视芯片供给分析

二、数字电视芯片需求分析

三、数字电视芯片价格分析

第三节 2011年中国数字电视芯片市场销售分析

第六章 2011年中国数字电视芯片竞争格局分析

第一节2011年中国数字电视芯片竞争现状

一、竞争主体及类别

二、国内外芯片厂商之间的竞争

第二节2011年中国数字电视芯片行业集中度分析

一、数字电视芯片市场集中度分析

二、数字电视芯片企业集中度分析

第三节2011年中国数字电视芯片企业竞争力策略分析

第七章2011年中国主流芯片厂商竞争力分析

第一节 ST意法半导体

第二节 Fujitsu富士通

第三节 NEC日电电子（瑞萨电子）

第四节 Zoran卓然

第五节 NXP恩智浦

第六节 Broadcom博通

第七节 Intel英特尔

第八节 TI德州仪器

第九节 Magnum

第十节 Sunplus凌阳科技

第十一节 ALi扬智科技

第十二节 Novatek（Cheertek）联咏科技

第十三节 Amlogic晶晨半导体

第十四节 Maxscend卓胜微电子

第十五节 Haier海尔集成

第十六节 HDIC上海高清

第十七节 LegendSilicon凌讯科技

第十八节 Nationalchip杭州国芯

第十九节 Availink中天联科

第二十节 Hisilicon海思半导体

第二十一节 澜起科技

第二十二节 龙晶微电子

第二十三节 微纳电子

第八章 2011年我国芯片设计行业运行新形势透析

第一节 2011年中国芯片设计行业运行总况

- 一、行业规模不断扩大
- 二、行业质量稳步提高
- 三、产品结构极大丰富
- 四、原材料与生产设备配套问题

第二节 2011年中国芯片设计运行动态分析

- 一、产业持续快速发展，但增速呈逐年放缓趋势
- 二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇
- 三、模拟IC和电源管理芯片成为国内IC设计热门产品

第三节 2011年中国芯片设计行业经济运行分析

- 一、2011年行业经济指标运行
- 二、芯片设计业进出口贸易现状
- 三、行业盈利能力与成长性分析

第四节 2011年中国芯片设计行业发展中存在的问题

- 一、企业规模问题分析
- 二、产业链问题分析
- 三、资金问题分析
- 四、人才问题分析
- 五、发展的建议与措施

第九章 2012-2016年中国数字电视芯片行业发展趋势及盈利预测分析

第一节 2012-2016年中国数字电视芯片产业发展前景分析

- 一、数字电视芯片技术方向分析
- 二、数字电视芯片价格预测分析

第二节 2012-2016年中国数字电视芯片市场预测分析

- 一、数字电视芯片市场供给预测分析
- 二、数字电视芯片需求预测分析
- 三、数字电视芯片竞争格局预测分析

第三节 2012-2016年中国数字电视芯片产业市场盈利预测分析

第十章 2012-2016年中国数字电视芯片行业投资机会与风险规避分析

第一节 2012-2016年中国数字电视芯片行业投资机会分析

- 一、数字电视芯片投资潜力分析
- 二、数字电视芯片投资吸引力分析

第二节 2012-2016年中国数字电视芯片行业投资风险分析

一、数字电视芯片行业竞争风险

二、数字电视芯片技术风险分析

三、政策风险分析

图表目录：（部分）

图表：2005-2010年上半年国内生产总值

图表：2005-2010年上半年居民消费价格涨跌幅度

图表：2010年上半年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2005-2010年上半年国家外汇储备

图表：2005-2010年上半年财政收入

图表：2005-2010年上半年全社会固定资产投资

图表：2010年上半年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2010年上半年固定资产投资新增主要生产能力

图表：数字电视芯片竞争厂商一览表

图表：芯片厂商产品类型一览表

图表：芯片厂商与机顶盒厂商合作情况一览表

图表：2005-2008 ST意法半导体公司MPEG解码器IC出货量

图表：ST有线机顶盒芯片产品一览表

图表：ST有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：富士通数字电视解决方案一览表

图表：富士通有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：NEC日电电子数字AV产品

图表：日电电子用于机顶盒/数字电视的EMMA应用

图表：日电电子用于机顶盒的MPEG解码器产品阵容

图表：日电电子基于EMMA的系列机顶盒解决方案

图表：NEC有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：Zoran机顶盒芯片方案一览表

图表：Zoran机顶盒芯片SupraTV 160系统框图

图表：卓然有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：恩智浦STB225结构示意图

图表：Broadcom BCM7405芯片解决方案

图表：博通有线机顶盒芯片出货情况一览表

图表：TI数字机顶盒(STB/PVR)设计方案示意图
图表：LSI SC2000芯片解决方案
图表：Sunplus凌阳科技机顶盒芯片产品一览表
图表：ALi机顶盒解决方案一览表
图表：卓胜微电子产品一览表
图表：海尔集成芯片产品一览表
图表：海尔基于Hi2011芯片平台完成的DMB-T系统示意图
图表：海尔集成机顶盒整体解决方案
图表：上海高清国标产品一览表
图表：上海高清ADTB-T解调芯片一览表
图表：上海高清国标解调芯片HD2815内部结构图
图表：凌讯科技数字电视芯片产品一览表
图表：凌讯科技TDS-OFDM解调芯片一览表
图表：凌讯科技信道解调芯片LGS-8G52芯片示意图
图表：杭州国芯数字电视芯片一览表
图表：中天联科基于AVL2108的卫星数字电视接收机前端设计示意图
图表 中天联科AVL2108芯片内部结构示意图
图表：中天联科基于AVL3106的地面数字电视接收机前端设计示意图
图表：海思Hi3110Q应用领域及典型应用图
图表：海思半导体数字电视机顶盒解决方案一览表
图表：海思半导体有线机顶盒芯片出货情况一览表
图表：澜起科技数字电视芯片一览表
图表：龙晶微电子AVS1.0解码专用芯片DS1000的架构
图表：龙晶微电子有线机顶盒解决方案系统框架图
图表：微纳电子中视一号典型应用图
图表：有线机顶盒芯片各地应用情况一览表
图表：略
更多图表见报告正文

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数

据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/tongxun1112/5912853SAW.html>